|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| logo_SINTEL |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ALLEGATO B - DICHIARAZIONE REQUISITI MINIMI INDEROGABILI** |
| GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER ATOMIC LAYER DEPOSITION (ALD) |
| CIG 98280478F2  CUP B53C22004310006 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **REQUISITO MINIMO INDEROGABILE** | **CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA OFFERTA**  Indicare, nella colonna evidenziata in verde, i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica richiesta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell’attrezzatura che rispondono al requisito. |
| **1** | Fornitura sistema per atomic layer deposition (ALD) completo di tutto l'hardware necessario a processi termici e al plasma dotato di interfaccia utente con software di controllo |  |
| **2** | Almeno 1 Kit di parti di ricambio compreso nella fornitura |  |
| **3** | Installazione e training di almeno 2 giornate compresi nella fornitura |  |
| **4** | Garanzia di almeno 12 mesi dalla data di accettazione del macchinario |  |
| **5** | Tempi di consegna non superiori a 12 mesi |  |
| **6** | Contratto di manutenzione annuale incluso nella fornitura di almeno 1 anno |  |
| **7** | Macchina compatibile con installazioni in cleanroom ISO6 o a pulizia superiore |  |
| **8** | Dimensione campione processabile: da piccoli campioni fino a wafer da 200 mm inclusi |  |
| **9** | Generatore di ozono con linea per ozono incluso nella fornitura |  |
| **10** | Sorgente al plasma per processo di plasma-ALD con relativa shower e generatore da almeno 300 W |  |
| **11** | Temperatura massima di processo di almeno 300 gradi centigradi |  |
| **12** | Loadlock per singolo wafer con gate valve di isolamento dalla camera di processo |  |
| **13** | Adattatori per: singolo wafer da 100 mm, singolo wafer da 150 mm e per 7 wafer da 2 pollici |  |
| **14** | Pompe da vuoto per pompaggio camera di processo e loadlock fino a pressioni base non superiori a 10^-2 m bar |  |
| **15** | Spessore massimo campione processabile di almeno 3 mm |  |
| **16** | Almeno 3 linee di precursori non gassosi non riscaldate |  |
| **17** | Almeno 2 linee di precursori non gassosi riscaldate |  |
| **18** | Temperatura massima raggiungibile dalle sorgenti riscaldate di almeno 200 gradi centigradi |  |
| **19** | Almeno 4 linee di precursori gassosi (ozono escluso) |  |
| **20** | Il software di acquisizione dello strumento deve permettere di salvare dati e metadati, senza perdita di informazioni, in un formato file apribile con software open source. In alternativa, devono essere fornite tutte le informazioni relative alla struttura e al contenuto del formato file salvato dallo strumento, per permettere di effettuare il parsing con un linguaggio di programmazione open source di tutti i dati e metadati contenuti senza perdita di informazioni. |  |
| **21** | Il software di controllo dello strumento dovrà permetterne la gestione, la programmazione di ricette di deposizione e diversi livelli utente per l’accesso al sistema. |  |